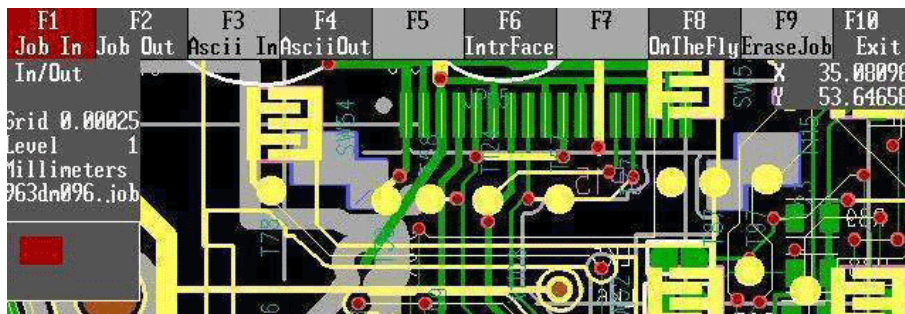




PADS2000→Gerber

1. 进入 PADS-PERFORM 画面, 打开一个文件



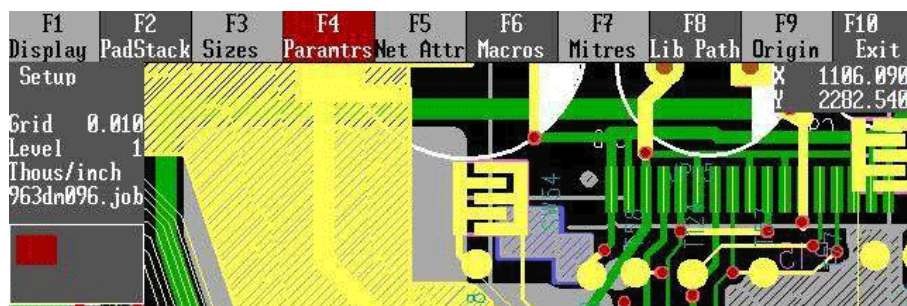
图一

注意到有铜皮未被填实的地方, 先来填铜皮;



图二

在图二中, 将 DataBase Unit Type 改为 Mils, Copper Hatch Grid 作适当调整 (这个值随要求不同而不同, 取决于铜皮或是网格), 顺便查一下改板的 Max Routing Level: 确定层数; 按右键退出至图三



图三

可以看到铺铜后的效果了!

在图三中按 F5, 查看个层的网络属性, 在多层板中, 如有电地层, 会在图四种的 PPlane 列显示出来, 以此来决定, 转换 Gerber 时是否转换电底层;



图四

在图三中, 按 F1 查看每层文件所打开的属性, 以决定转 Gerber 时选项的打开和关闭;



图五

在主菜单下选择 CAM, 设置好存盘路径, 进入 CAM 模块。点击 Drill 出现图六画面, 有几个选项需说明:

第二行是指元器件孔 (具体说就是非过孔), Plated 代表金属化孔, Non-plated 代表非金属化孔, 本人多次发现, 许多工程师忘记选中非金属化孔, 导致缺失安装孔, 切记切记!

第三行是指过孔, Thru 代表 Top-Bot 过孔, Partial 代表半通孔 (埋孔或盲孔); 设置完, 点击 start 既可转换钻孔文件!

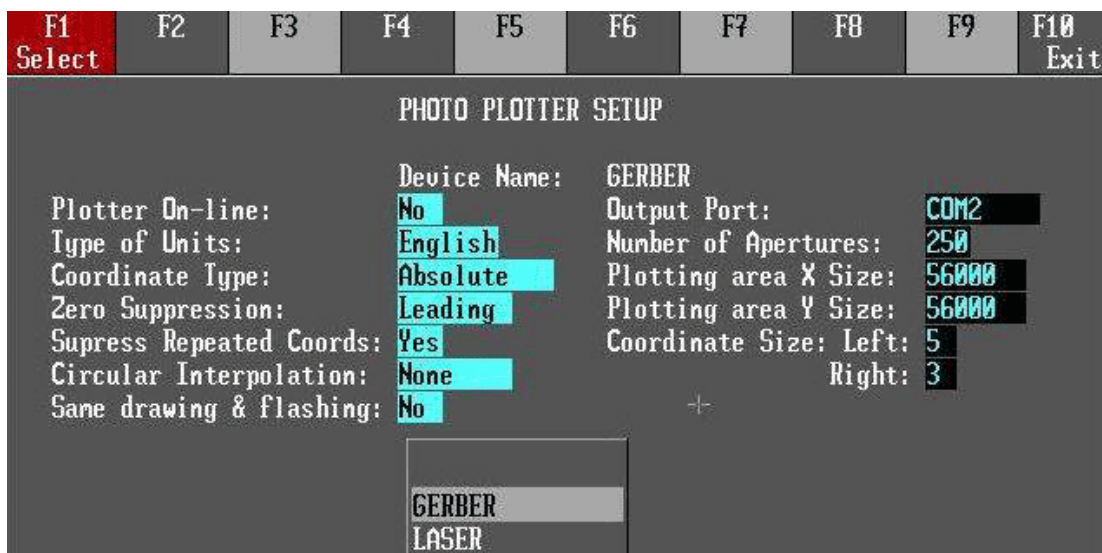


图六



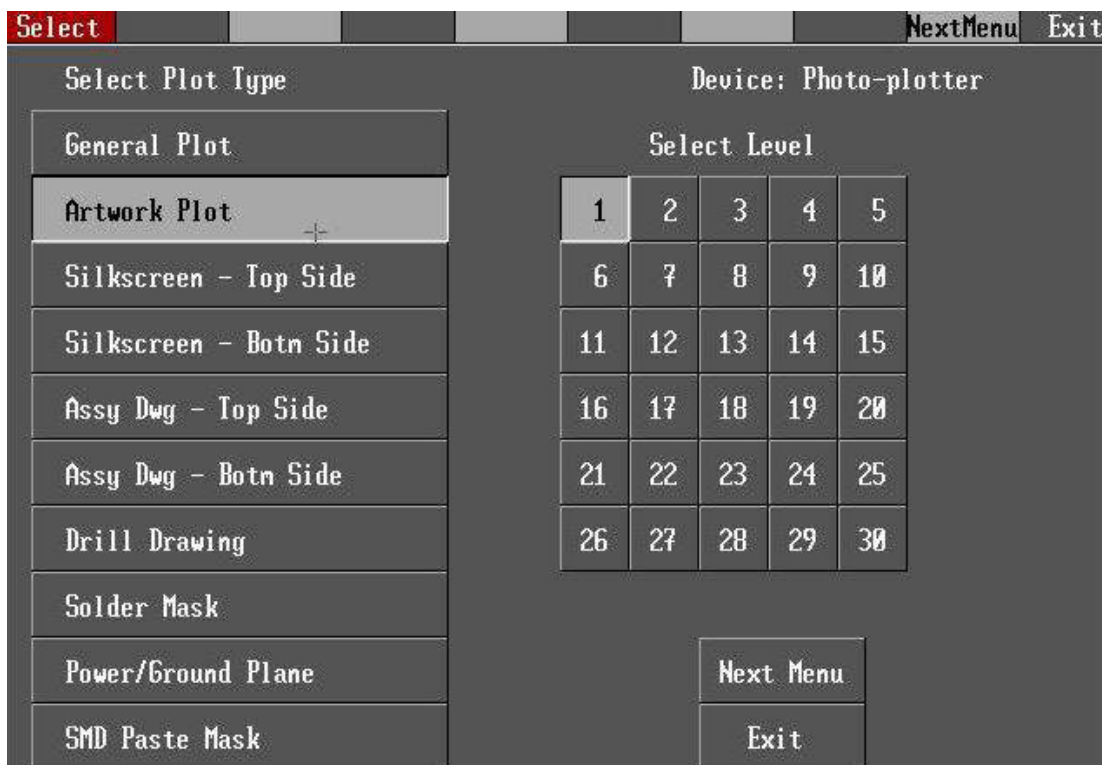
在 CAM 功能菜单中, 点击 device, 选择 PHOTO PLOTTER 设置参数, 在选中 GERBER, 有三个选项需注意:

- ①.Number of Apertures 数值应足够大, 它代表使用的光圈数, 光圈数越多, 自动匹配的几率越大;
- ②.Plotting area X Size
- ③.Plotting area Y Size 应依据板的尺寸, 给出合适的选择, 否则, 系统会提示尺寸偏小;



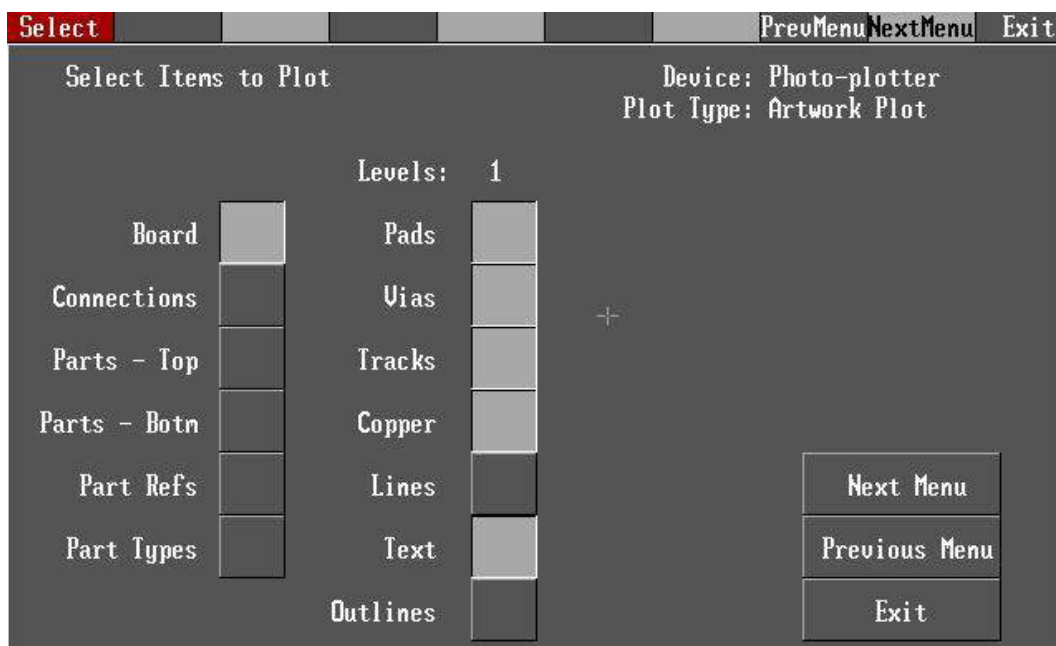
图七

做完以上设置, 下次就不用再次设置了。接下来, 我们开始转换 Gerber, 在 CAM 模块中选择 Photo plot, 出现图八的画面, Artwork Plot 是指走线层, 有几层走线, 就要操作几次;



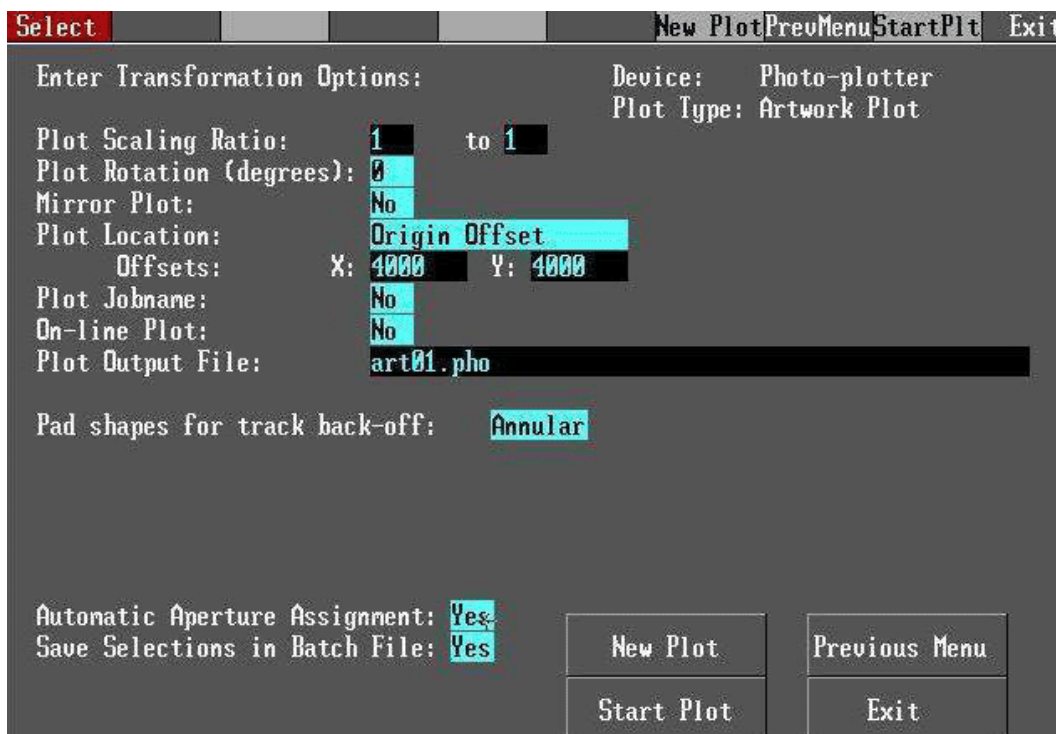
图八

点击 Next 进入图九, 设置走线层应打开的选项, 这就是为何要查看图五的原因;



图九

点击 Next 进入图十画面，记着把 Automatic Aperture Assignment 选中，这样，系统自动匹配光圈；有几层走线层就执行几次图八到图十的过程；

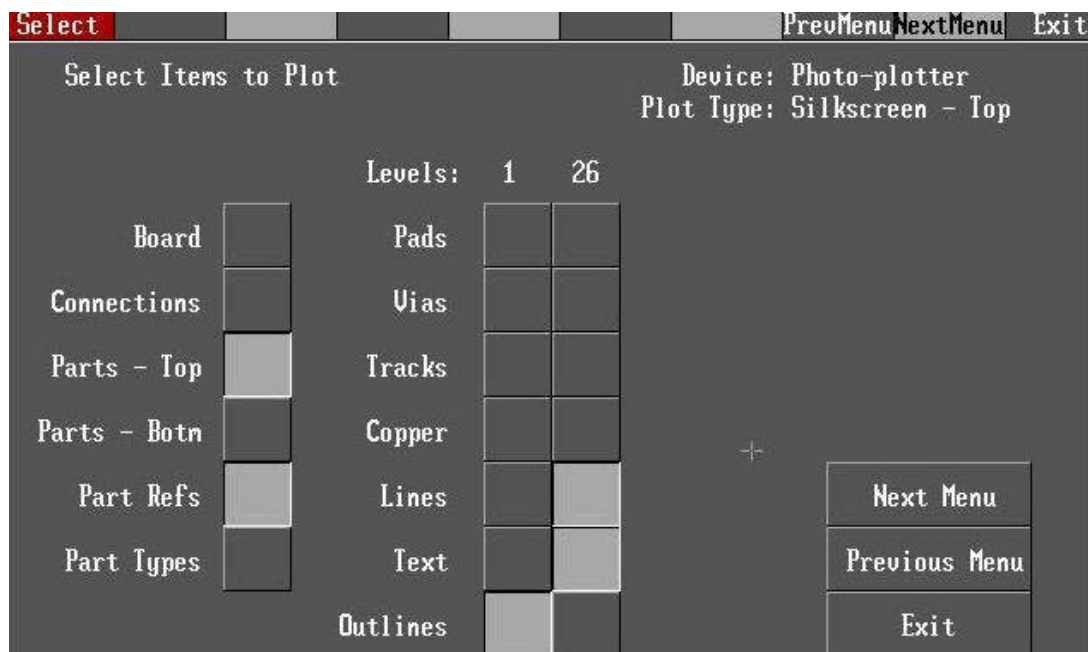


图十

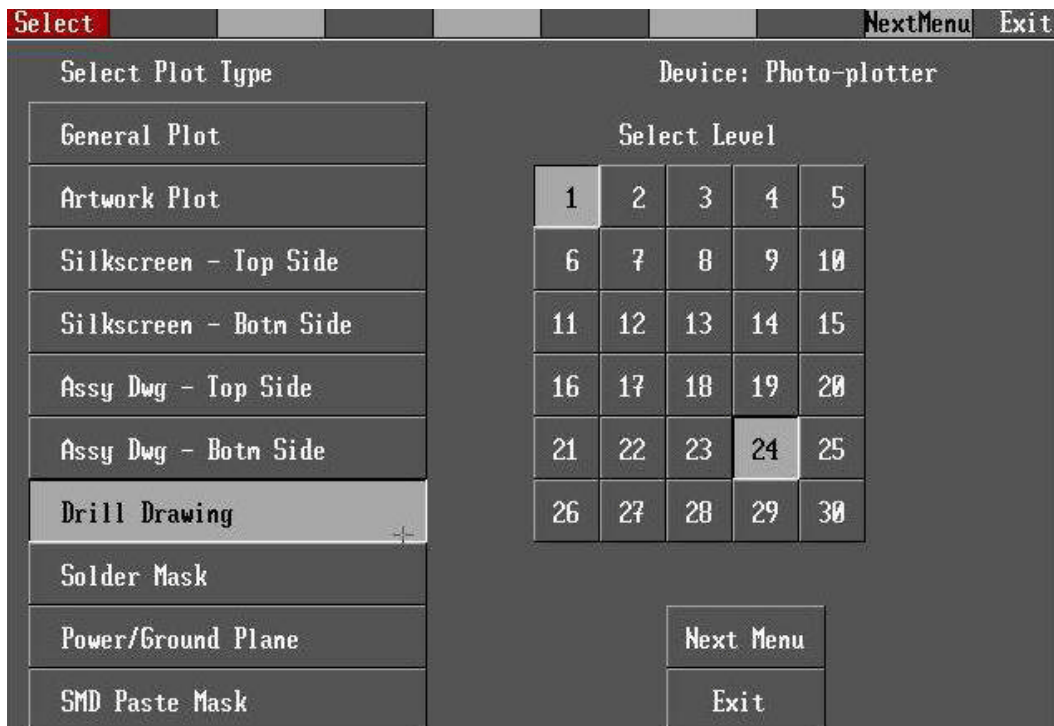
再转换丝印层，系统已经区分开顶层丝印和底层丝印，在图十一中，如果有其它层的信息需要出现在丝印层，也需在右边的小方块中选中相应的数字；



图十一

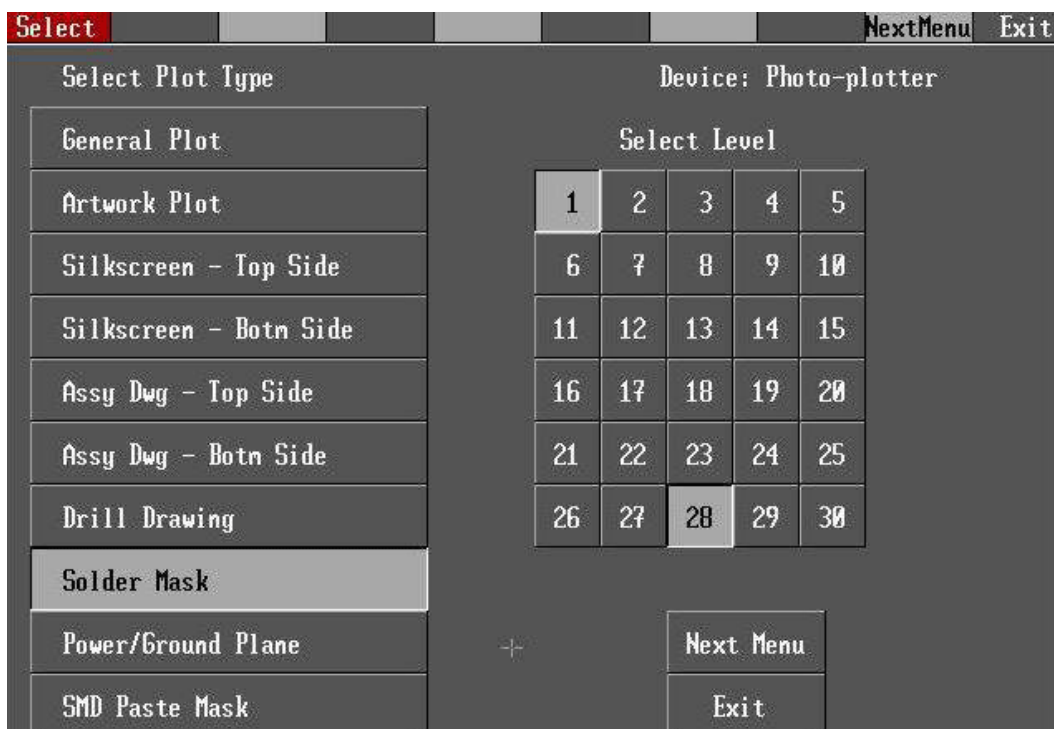


图十二



图十三

图十三是转换孔位图;



图十四

图十四是转绿油层, 需分两次分别转换顶层绿油和底层绿油;



图十五

图十五是转换电地层，这就是我们检查各层网络属性的原因，25层是电地层的公用层，需分别匹配电地层来转换！